

各位

2017年8月8日

(一社)日本電子デバイス産業協会

アクションセミナー委員長 甕 秀樹

第16回 NEDIA アクションセミナー開催のご案内

NEDIA では、企画委員会をアクションセミナー委員会と改称し、会員様向けに、タイムリー、かつ役立つ業界情報を提供し、会員様の価値向上を図るべく、これまで以上に革新的なアクションセミナーを企画し開催をしていきます。

第15回までは企画委員会として、自動車、パワーデバイス関係、半導体業界・製造装置業界の動向、半導体基礎、有機 EL ディスプレイ産業の動向について開催してきましたが、アクションセミナー委員会として最初となる今回は、IoT 時代において重要なモジュールビジネスにパラダイムシフトをおこす FO-WLP 技術について、この分野における知見の深い講師を迎え、開催することにしました。ぜひ多くの会員様にご参加頂けることを心よりお待ちしております。

——— 開催案内 ———

1. 開催日時：2017年9月15日(金) 17:00～18:30
2. 開催場所：UT アドバンスト・キャリアセンター (UTACC) セミナールーム
東京都品川区東五反田 1-2-33 白雉子ビル 4階 <http://www.ut-g.com/utacc/>
JR 山手線 五反田駅東口より徒歩5分 / 地下鉄浅草線 五反田駅 A6 番出口より徒歩3分
3. テーマ：「ヘテロジニアス・インテグレイション (FO-WLP) と今後の動向
～モジュールビジネスのパラダイムシフト」
＜講演概要＞
部品内蔵基板は、多層板の内側に薄化したベア IC や受動部品などを埋め込み、基板表面にもさらにデバイスを実装・搭載することでモジュール基板面積を極力小型化する技術である。ここ
にきて、アップル社のスマホの AP (アプリケーションプロセッサ) に搭載された FO-WLP が注
目されており、超薄 IC と超小型部品の 3D 化と共に取り巻く周辺技術について、「ヘテロジニ
アス・インテグレイションの今後の動向」として講演する。
4. 講師：土門 孝彰 氏
元 TDK 生産本部テクニカル・アドバイザー、現：秋田銀行 地域サポート部チーフア
ドバイザー、エレクトロニクス実装学会 常任理事/エグゼクティブフェロー
5. タイムテーブル：16:30～受付開始
17:00～18:00 セミナー
18:00～質疑応答 (終了は 18:30 予定)
6. 参加費：NEDIA 会員 1,000 円、非会員 3,000 円
ご参加の申込みは、9 月 11 日(月)までにメールにて事務局までお願い致します。
申込みを確認後、事務局より返信いたします。
定員(約 40 名程度)になりましたら、申込みの受け付けを終了させていただきます。
＜事務局連絡先＞

E-mail : info@nedia.or.jp TEL : 03-5823-4465 FAX : 03-5823-4475

以上